

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

## 湖北鼎龙控股股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20260522

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称 及人员姓名	华夏基金：胡杰、潘中宁、卢少强、张雪韬、贾静雯、马新凯，华泰证券：吕兰兰，共7名投资者
时间	2026年5月21日下午14:00~15:30
地点	公司9楼会议室
上市公司接待 人员姓名	2026年5月21日下午14:00~15:30：董事会秘书杨平彩女士
投资者 关系活动 主要内容 介绍	<p><b>公司介绍：</b></p> <p>公司是国内领先的关键大赛道领域中各类核心创新材料的平台型公司，主营业务横跨两大板块—半导体业务板块、锂电业务板块。现阶段，公司重点聚焦半导体创新材料业务，业务覆盖：半导体制造用CMP工艺材料和晶圆光刻胶、半导体显示材料、半导体先进封装材料三个细分板块，是集成电路用CMP抛光垫国内供应龙头，占据OLED新型显示材料YPI、PSPI国内供应领先地位，深度布局半导体KrF/ArF晶圆光刻胶、半导体先进封装材料等业务，新近切入新能源锂电关键功能材料领域，推动公司高速可持续发展。</p> <p><b>问1：公司在半导体材料领域的核心竞争优势主要体现在哪些方面，以持续巩固国产领先地位？</b></p> <p><b>答：</b>公司深耕半导体关键材料领域多年，已构建起技术研发、产品矩阵、产业链一体化、客户验证、品质管控等多维度核心竞争壁垒，是国内少数实现多款核心半导体材料规模化的平台型企业，核心竞争优势具体如下：</p> <p>完整的技术研发与配方壁垒优势。公司长期坚持自主研发，核心配方、生产工艺均实现自主化，掌握CMP抛光材料、高端晶圆光刻胶、其他半导体耗材等核心产品的底层技术。依托持续的研发投入与技术迭代，能够快速适配国内晶圆厂全制程多工艺节点需求，产品性能、稳定性持续对标国际头</p>

部厂商，技术领先性突出。

**多元化产品矩阵与平台化协同优势：**公司已形成以 CMP 抛光材料为核心，高端晶圆光刻胶、先进封装等多款材料协同发展的产品矩阵，可满足下游晶圆制造、封测环节多品类材料需求。多产品布局能够深度绑定下游晶圆制造客户，实现客户资源共享、技术经验复用、渠道协同拓展，是国内稀缺的半导体材料平台型企业。

**全产业链一体化与产能保障优势：**公司布局从核心原材料、配方制备、精密加工、自动化生产到精密检测的全流程生产体系，实现关键环节自主化，有效保障产品一致性、批次稳定性。同时持续推进高端产线建设与产能扩充，自动化、精细化生产水平行业领先，能够匹配下游客户规模化放量的产能需求。

**精细化品质管控与本土化服务优势：**公司建立对标国际标准的严苛质量管控体系，覆盖研发、生产、检测、交付全流程；依托本土化运营优势，能够快速响应下游晶圆厂工艺调整、定制化开发、现场技术服务等需求，实现高效的技术对接、问题反馈与产品迭代。

**问 2：公司未来几年整体经营战略规划是什么，各核心业务板块的发展侧重点如何划分？**

**答：**公司立足高端新材料平台化发展的总体定位，依托多年沉淀的高分子材料、精密制造、配方研发、品质管控及产业链整合能力，紧抓半导体材料产业化、新能源产业高速发展的时代机遇，坚持内生增长 + 外延拓展双轮驱动，持续优化业务结构，做强存量核心业务、做大增量新兴业务，构建多板块协同增长格局，提升公司长期可持续经营能力与综合竞争实力。未来几年，公司将坚持半导体材料为主业根基、新能源锂电材料为第二增长曲线的总体发展战略，以技术创新为核心驱动力，持续加大研发投入、产能建设、客户拓展与产业链整合力度；深耕半导体关键材料赛道，巩固国内抛光垫龙头地位，持续拓展其他半导体配套材料，完善半导体材料平台化布局，同时积极布局新能源锂电高端新材料领域，实现技术赋能、产业落地与规模化放量，打造新的业绩增长引擎。

半导体材料板块是公司战略核心，未来重点围绕高端化、先进化、平台化、规模化方向发力。以 CMP 抛光垫为核心突破口，持续推进 12 英寸高端晶圆用抛光垫在国内头部晶圆厂的验证导入与批量供货，加快技术迭代，提升国内市场占有率，稳固国产抛光垫龙头优势；同步推进抛光液清洗液、显示材料、先进封装、高端晶圆光刻胶等半导体材料的研发、验证与商业化落地，丰富半导体材料产品矩阵，并完善全流程质量管控体系，深化与下游客户的深度绑定。新能源锂电辅材板块作为公司中长期重点布局的新兴赛道，未来公司将通过产业合作、产能共建、技术赋能等模式，稳步扩大产业化规模，构建公司新的业绩增长极。

**问 3：公司抛光垫产品在 12 英寸高端晶圆领域的客户拓展与产能匹配情况如何？**

**答：**抛光垫为公司半导体材料板块核心主力产品，公司深耕该领域多年，凭借稳定的产品性能、完善的质量管控体系及本土化快速服务优势，持续推

进全尺寸、全制程晶圆用抛光垫的客户覆盖与产能布局，产能建设可有效匹配下游市场需求。

在客户情况方面，公司抛光垫产品已全面覆盖国内主流晶圆制造企业，覆盖全制程的多类工艺节点，应用于逻辑芯片、存储芯片等多类生产场景。公司持续深化与存量核心客户的合作深度，不断扩大供货品类与供货规模；同时积极拓展新增晶圆制造客户，持续推进 12 英寸高端晶圆用抛光垫的批量供货工作，依托抛光垫产品在平坦化性能、批次稳定性、工艺适配性等方面的综合优势，客户认可度持续提升，国内市场的渗透率稳步提高，为业务持续放量奠定坚实的客户基础。

在产能匹配情况方面，公司围绕晶圆领域抛光垫的市场需求，持续推进专业化、规模化、高端化抛光垫生产基地建设，已搭建了从原材料配方、精密成型、后段加工到精密检测的全流程自主产线。针对不同规格晶圆用抛光垫，不断升级高端自动化产线，优化生产效率，现有产能可充分满足当前客户现有订单交付需求，同时公司根据下游晶圆产能扩张节奏及客户导入进度，有序推进产能扩充与产线升级，提前做好产能储备，能够匹配未来客户规模化放量的长期供货需求，保障产品交付及时、供应稳定，支撑公司抛光垫业务持续提升国内市场占有率。

#### **问 4：公司近期布局新能源锂电相关业务，该板块现阶段业务进展、合作模式及未来发展定位是怎样的？**

**答：**公司基于材料平台化发展战略，依托自身在高分子材料、精密制造、材料配方研发、供应链管理等方面的核心技术积累与产业化优势，积极拓展新能源锂电材料领域新赛道，完善新材料业务矩阵，培育第二增长曲线，相关业务现阶段整体推进有序。

在现阶段业务进展方面，公司围绕新能源锂电关键材料领域开展前瞻性布局与产业化落地，成功切入锂电相关材料赛道，稳步推进项目建设、技术研发、产品试样及产业化工作。目前将逐步完成核心技术储备、产线规划搭建、工艺优化迭代，持续开展下游锂电产业链头部企业的新品测试、性能验证，同时，公司充分复用在半导体材料领域沉淀的精细化生产管理、质量管控体系、精密制造能力，保障锂电材料产品的一致性与稳定性。

在合作模式方面，公司结合自身产业资源、技术优势及行业发展特点，采用技术赋能 + 产能共建相结合的多元模式布局锂电业务。一方面整合上下游资源，实现技术互补、产能共享，公司现有 PI 材料、微球、氧化材料等创新材料的技术，可拓展至锂电辅材应用场景，丰富双方产品的市场空间，公司在碳粉生产领域的成熟工艺，与皓飞新材的锂电辅材生产技术可相互复用，降低研发成本、提升生产效率，同时双方可联合攻关新型导电剂、固态电解质等高端锂电辅材技术，加速技术迭代；另一方面发挥公司在高分子合成、配方开发、品质管控等方面的技术赋能优势，为合作项目提供研发、工艺、质量管控等全方位支持，同时依托自身成熟的商业化运营体系，拓展下游锂电企业客户渠道，构建稳定高效的产业合作生态，提升业务拓展效率。

在未来发展定位方面，公司将新能源锂电业务定位为新材料板块重要的战略新兴业务与第二增长曲线，聚焦锂电领域高技术壁垒的关键细分材料赛道，坚持高端化、差异化发展路线。依托公司平台化新材料发展战略，持续

	<p>加大研发投入，强化技术创新与产品迭代，稳步扩大产业化规模。未来公司将以技术为核心、以市场为导向，逐步提升锂电相关材料的市场渗透率与行业影响力，进一步拓宽公司新材料业务版图，提升公司整体长期盈利能力，助力公司打造国内领先的综合性高端新材料平台型企业。</p> <p><b>问 5：公司抛光液业务当前客户认证与批量供货进展如何，未来产能建设与高端产品研发方向主要聚焦哪些方面？</b></p> <p><b>答：</b>抛光液作为半导体 CMP 工艺核心配套材料，与公司现有抛光垫业务具备极强的技术、客户、渠道协同性，是公司完善材料平台化布局的重要发力方向，目前客户认证、批量供货、产能建设及高端研发均按照既定规划有序推进，整体发展态势良好。</p> <p>公司依托在抛光垫领域积累的深厚客户资源、精密材料研发经验、下游晶圆厂工艺适配能力及本土化服务优势，持续推进不同应用场景、不同制程节点抛光液产品的客户导入工作。近期大硅片精抛液、氧化铈抛光液、先进封装 TSV 抛光液三款产品接连实现技术突破并斩获批量订单，有助于驱动产能利用率进一步提升。现阶段，公司抛光液已覆盖铜制程、钨制程、大硅片精抛、氧化铈、先进封装 TSV 等全制程品类，产品矩阵进一步完善，产品在抛光效率、稳定性、批次一致性等关键指标上持续优化，验证及导入节奏稳步加快。同时公司充分发挥抛光垫 + 抛光液一体化配套服务优势，深度对接下游客户整体国产化替代需求，进一步提升客户粘性与导入效率，为后续规模化放量奠定良好基础。</p> <p>围绕抛光液中长期商业化放量需求，公司将统筹规划专业化、规范化的抛光液生产基地布局，仙桃园区万吨级抛光液及配套纳米研磨粒子产线逐步稳定运行，武汉本部产能协同配套，可充分满足多品类产品规模化交付需求。产能布局上，优先匹配下游规模化供货需求，同步预留一定抛光液产能拓展空间，实现多品类、多规格抛光液产品的高效生产；持续完善全链条配套能力，保障产品交付稳定性、批次一致性与供应安全性，支撑业务快速放量。</p> <p>未来公司抛光液研发将紧扣国内半导体产业升级趋势，聚焦高端化、定制化、一体化配套三大核心方向：一是聚焦全制程抛光液研发，针对更高工艺节点逻辑、存储芯片应用场景，持续对标国际主流产品性能；二是聚焦多品类抛光液开发，完善产品细分布局；三是强化抛光垫-抛光液一体化协同研发，结合公司抛光垫技术积累，优化二者匹配性与工艺适配性，形成整体解决方案优势，提升对下游客户的综合服务能力，持续巩固公司在国内半导体 CMP 领域的平台化竞争优势。</p>
附件清单	无
日期	2026 年 5 月 21 日